

2018-2024年中国汽车芯片行业市场评估分析及投资发展盈利预测报告

报告大纲

一、报告简介

华经情报网发布的《2018-2024年中国汽车芯片行业市场评估分析及投资发展盈利预测报告》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<https://www.huaon.com/detail/353538.html>

报告价格：电子版: 9000元 纸介版：9000元 电子和纸介版: 9200元

订购电话: 400-700-0142 010-80392465

电子邮箱: kf@huaon.com

联系人: 刘老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、报告目录及图表目录

报告目录:

第一章 汽车芯片行业发展环境分析

1.1 国际环境

1.1.1 全球发展规模

1.1.2 亚太地区发展

1.1.3 欧洲主导市场

1.1.4 美国ADAS发展

1.2 政策环境

1.2.1 智能制造政策

1.2.2 集成电路政策

1.2.3 半导体产业规划

1.2.4 “互联网+”政策

1.3 经济环境

1.3.1 国民经济运行

1.3.2 工业经济增长

1.3.3 固定资产投资

1.3.4 转型升级形势

1.3.5 宏观经济趋势

1.4 汽车工业

1.4.1 行业发展势头

1.4.2 市场产销规模

1.4.3 外贸市场规模

1.4.4 发展前景展望

1.5 社会环境

1.5.1 互联网加速发展

1.5.2 智能产品的普及

1.5.3 科技人才队伍壮大

第二章 2015-2017年中国汽车芯片行业发展分析

2.1 2015-2017年中国汽车芯片发展总况

2.1.1 行业发展概述

2.1.2 产业发展形势

2.1.3 市场发展规模

2.2 2015-2017年中国汽车芯片市场竞争形势

2.2.1 市场竞争格局

2.2.2 巨头争相进入

2.2.3 半导体抢占主战场

2.3 2015-2017年汽车芯片技术发展进展

2.3.1 技术研发进展

2.3.2 无线芯片技术

2.3.3 技术发展趋势

2.4 中国汽车芯片行业发展困境分析

2.4.1 过度依赖进口

2.4.2 技术研发不足

2.4.3 行业发展瓶颈

2.5 中国汽车芯片市场对策建议分析

2.5.1 行业发展建议

2.5.2 产业突围策略

2.5.3 企业发展策略

第三章 2015-2017年中国汽车芯片行业产业链分析

3.1 2015-2017年中国半导体材料行业运行状况

3.1.1 产业发展特点

3.1.2 行业销售规模

3.1.3 市场格局分析

3.1.4 产业转型升级

3.1.5 行业发展建议

3.1.6 行业发展趋势

3.2 2015-2017年中国芯片设计行业发展分析

3.2.1 产业发展历程

3.2.2 市场发展现状

3.2.3 市场竞争格局

3.2.4 企业专利情况

3.2.5 国内外差距分析

3.3 2015-2017年中国晶圆代工产业发展分析

3.3.1 晶圆加工技术

3.3.2 国外发展模式

3.3.3 国内发展模式

3.3.4 企业竞争现状

3.3.5 市场布局分析

3.3.6 产业面临挑战

3.4 2015-2017年中国芯片封装测试行业发展分析

3.4.1 封装技术介绍

3.4.2 芯片测试原理

3.4.3 主要测试分类

3.4.4 封装市场现状

3.4.5 封测竞争格局

3.4.6 发展面临问题

3.4.7 技术发展趋势

第四章 2015-2017年中国汽车芯片行业区域发展分析

4.1 长春

4.1.1 产业发展成就

4.1.2 台企投资动态

4.1.3 产业集群发展

4.2 芜湖

4.2.1 产业支撑政策

4.2.2 产业基地概况

4.2.3 企业项目建设

4.2.4 产业发展目标

4.2.5 产业发展规划

4.3 上海

4.3.1 行业发展成就分析

4.3.2 行业发展促进战略

4.3.3 产业发展专项方案

4.3.4 行业发展瓶颈分析

4.4 深圳

4.4.1 产业发展优势

4.4.2 产业发展成就

4.4.3 产业链的市场

4.4.4 产业发展动态

4.5 其他地区

4.5.1 合肥市

4.5.2 十堰市

4.5.3 东莞市

第五章 2015-2017年汽车芯片主要应用市场发展分析

5.1 ADAS

5.1.1 ADAS发展地位

5.1.2 市场竞争现状

5.1.3 技术创新核心

5.1.4 芯片技术发展

5.1.5 投资机遇分析

5.1.6 发展趋势分析

5.1.7 未来发展前景

5.2 ABS

5.2.1 系统工作原理

5.2.2 系统优劣分析

5.2.3 中国发展进展

5.2.4 系统发展趋势

5.3 车载导航

5.3.1 市场发展现状

5.3.2 企业竞争格局

5.3.3 产品的智能化

5.3.4 发展问题剖析

5.3.5 未来发展方向

5.4 空调系统

5.4.1 市场发展形势

5.4.2 市场规模分析

5.4.3 企业竞争格局

5.4.4 未来发展方向

5.5 自动泊车系统

5.5.1 系统运作原理

5.5.2 关键技术发展

5.5.3 技术推进动态

5.5.4 未来市场前景

第六章 2015-2017年汽车电子市场发展分析

6.1 国际汽车电子市场概况

6.1.1 主要产品综述

6.1.2 行业发展状况

6.1.3 市场规模发展

6.2 中国汽车电子行业发展概述

6.2.1 市场发展特点

6.2.2 产业发展地位

6.2.3 产业发展阶段

6.2.4 发展驱动因素

6.2.5 市场结构分析

6.2.6 引领汽车发展方向

6.3 2015-2017年中国汽车电子市场发展分析

6.3.1 市场规模现状

6.3.2 出口市场状况

6.3.3 市场结构分析

6.3.4 汽车电子渗透率

6.4 2015-2017年汽车电子市场竞争分析

6.4.1 整体竞争态势

6.4.2 市场竞争现状

6.4.3 区域竞争格局

6.4.4 市场竞争格局

6.4.5 重点厂商SWOT解析

6.4.6 本土企业竞争策略

6.5 汽车电子市场发展存在的问题

6.5.1 市场面临挑战

6.5.2 产业制约因素

6.5.3 创新能力不足

6.6 中国汽车电子市场发展策略及建议

6.6.1 产业链构建策略

6.6.2 产业发展壮大对策

6.6.3 产业专项规划构思

6.6.4 网络营销策略分析

第七章 2015-2017年国外汽车芯片重点企业运营分析

7.1 高通

7.1.1 企业发展简况分析

7.1.2 企业经营情况分析

7.1.3 企业经营优劣势分析

7.2 英特尔

7.2.1 企业发展简况分析

7.2.2 企业经营情况分析

7.2.3 企业经营优劣势分析

7.3 英飞凌

7.3.1 企业发展简况分析

7.3.2 企业经营情况分析

7.3.3 企业经营优劣势分析

7.4 意法半导体

7.4.1 企业发展简况分析

7.4.2 企业经营情况分析

7.4.3 企业经营优劣势分析

7.5 瑞萨科技

7.5.1 企业发展简况分析

7.5.2 企业经营情况分析

7.5.3 企业经营优劣势分析

7.6 博世

7.6.1 企业发展简况分析

7.6.2 企业经营情况分析

7.6.3 企业经营优劣势分析

7.7 德州仪器

7.7.1 企业发展简况分析

7.7.2 企业经营情况分析

7.7.3 企业经营优劣势分析

7.8 索尼

7.8.1 企业发展简况分析

7.8.2 企业经营情况分析

7.8.3 企业经营优劣势分析

第八章 2015-2017年中国汽车芯片重点企业运营分析

8.1 比亚迪股份有限公司

8.1.1 企业发展简况分析

8.1.2 企业经营情况分析

8.1.3 企业经营优劣势分析

8.2 中芯国际集成电路制造有限公司

8.2.1 企业发展简况分析

8.2.2 企业经营情况分析

8.2.3 企业经营优劣势分析

8.3 大唐电信科技股份有限公司

8.3.1 企业发展简况分析

8.3.2 企业经营情况分析

8.3.3 企业经营优劣势分析

8.4 上海先进半导体制造股份有限公司

8.4.1 企业发展简况分析

8.4.2 企业经营情况分析

8.4.3 企业经营优劣势分析

8.5 珠海全志科技股份有限公司

8.5.1 企业发展简况分析

8.5.2 企业经营情况分析

8.5.3 企业经营优劣势分析

第九章 中国汽车芯片行业投资机遇分析

9.1 投资机遇分析

9.1.1 产业爆发增长

9.1.2 巨头加速布局

9.1.3 智能汽车发展加速

9.2 产业并购动态

9.2.1 高通

9.2.2 三星

9.2.3 瑞萨电子

9.3 并购加速动因

9.3.1 汽车数字化推进

9.3.2 半导体行业助力

9.3.3 汽车数字商机爆发

9.3.4 车用晶圆技术发展

9.4 投资风险分析

9.4.1 宏观经济风险

9.4.2 环保相关风险

9.4.3 产业结构性风险

9.5 融资策略分析

9.5.1 项目包装融资

9.5.2 高新技术融资

9.5.3 BOT项目融资

9.5.4 IFC国际融资

9.5.5 专项资金融资

第十章 中国汽车芯片产业未来发展前景展望（AK LT）

10.1 中国汽车电子市场前景展望

10.1.1 全球市场机遇

10.1.2 市场需求分析

10.1.3 十三五发展趋势

10.1.4 产品发展方向

10.2 中国汽车芯片产业未来前景预测

10.2.1 未来发展规模

10.2.2 市场规模预测

10.2.3 芯片需求市场

图表目录：

图表 亚太各地区晶片销售金额与全球占比（依应用别区分）

图表 2018-2024年美国ADAS市场规模及预期

图表 2017年美国汽车市场ADAS功能使用现状

图表 2018-2024年美国汽车市场防碰撞预警功能安装趋势

图表 智能制造系统架构

图表 智能制造系统层级

图表 MES制造执行与反馈流程

图表 云平台体系架构

图表 2011-2017年国内生产总值及其增长速度

图表 2017年年末人口数及其构成

图表 2011-2017年城镇新增就业人数

图表 2011-2017年全员劳动生产率

图表 2017年居民消费价格月度涨跌幅度

更多图表见正文.....2018-2024年中国汽车芯片行业市场评估分析及投资发展盈利预测报告
报告目录:

详细请访问：<https://www.huaon.com/detail/353538.html>